. صباح انور سلمان د. حسي حسي مبر . جامعة ديالي/كلية العلوم

الخلاصة: تم قياس المقاومية لأغشية 2(UIn (Se<sub>0.2</sub>Te<sub>0.8</sub>) و CuIn (Se<sub>0.8</sub> و CuIn (Se<sub>0.2</sub>Te<sub>0.8</sub>) 2(2.2 الرقيقة والمحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ بسمك قدره (Te<sub>0.2</sub>) ضمن المدى الحراري (A73K-300) للعينات كما تم ترسيبها وللعينات التي خضعت الى عملية التلدين عند درجات الحرارة (K 373 K) و (473 K) لمدة ساعة بوجود الفراغ (Torr).

Abstract:

It had been measuring the resistivity for the CuIn  $(Se_{0.2}Te_{0.8})_2$  and CuIn  $(Se_{0.8}Te_{0.2})_2$  thin films which perpetrated by vacuum thermal evaporation with a thickness of  $(225\pm5nm)$  in the thermal range of (300-473K) for both as deposited and annealed samples at temperatures (373K, 473K) for one hour in the existence vacuum  $(10^{-2}Torr)$ .

It had been calculation activation energies for these films before and after annealing.

المقدمة

ان المركب CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> المركب CuIn . (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> الشبه موصلة. وهو من المركبات المتبلورة على هيئة تركيب الجالكوباير ايت (Chalcopyrite)<sup>[1]</sup>. تعتبر الاغشية الرقيقة المحضرة من المركب CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> الاحلايل المركب cuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> الحلايل الشمسية <sup>[7]</sup> حيث استخدمت بشكل مكثف في مجال ابحاث الخلايا الشمسية (<sup>1</sup>) حيث المحدمة بشكل مكثف في مجال ابحاث الخلايا الشمسية (Heterojunction photovoltaic celles) بالاضافة الى ذلك تستخدم هذه الاغشية في تطبيقات الألكترونيات الضوئية (Photoelectronics) كاستخدامها كدايودات باعثة للضوء (L.E.D) (Light emission diodes)

الجانب العملي

تم تبخير اغشية <sub>2</sub>(x=0.2, 0.8) للرقيقة عند قيم (0.8, x=0.2, 0.8) باستخدام طريقة التبخير الحراري في الفراغ CuIn (kermal ديث تم تبخير مسحوق المركب (Vacuum thermal المتعدد evaporation) التبلور باستخدام حويض مولبيديوم (Mo). لقد تم تحضير المسحوق بواسطة مزج (Se معينة من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (In) والسلينيوم (Se) نسب ذرية معينة من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (Te) والسلينيوم (Se) وموجب قيمة الى التليريوم (Te) ميث كانت هذه العناصر نقية بدرجة (Mo) والعناصر (Se من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (In) والسلينيوم (Se) وموجب قيمة الي التليريوم (Cu) وزن النحاسر نقية بدرجة (Mo) والانديوم (In) والعناصر العناصر المرابعة الى التليريوم (Te) والانديوم (Se) من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (Se) والانديوم (In) والعنامير المرابعة الى التليريوم (Te) ميث كانت هذه العناصر نقية بدرجة (Mo) والانديوم (Se) وموجب قيمة من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (Se) والانديوم (Te) والعنامير (Se) والانديوم (Te) والعنامير (Cu) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Te) والعناوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Te) والعناوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Te) والانديوم (Se) والوم والوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والوم والوم والايوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والانديوم (Se) والوم والوم (Se) والوم والوم والوم والوم والوم (Se) والوم والوم والوم والوم والوم والوم والوم والوم والوم والالوم والوم و

تم وضع هذه الانبوبة داخل فرن كهربائي انبوبي عند درجة حرارة (1373K) لمدة (٢٤) ساعة<sup>[7]</sup>، ثم تبريد الانبوبة تدريجيا الى درجة حرارة الغرفة (R.T).

تسم استخدام قواعد من زجاج البايركس (Pyrex) لترسيب اغشية CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> وتم قياس سمك هذه الاغشية باستخدام الطريقة الوزنية.

CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> لاغشية (Annealing) لتم اجراء عملية التلدين (Annealing) لاغشية التراء عملية التلدين ((373k) و ((373k) لمدة ساعة بوجود الفراغ.

النتائج والمناقشة

تم اجراء القياسات الكهربائية لأغشية CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>)<sub>2</sub> و CuIn (Se<sub>0.8</sub> Te<sub>0.2</sub>)<sub>2</sub> الرقيقية والتي تتضمن قياس المقاومية (ρ) خلال مديات حرارية من درجة حرارة الغرفة (R.T) الى درجة حرارة (473K) والتي من خلالها تم حساب طاقات التنشيط باستخدام المعادلة الاتية:

 $\sigma = \sigma_{\rm o} \exp(-E_{\rm a}/K_{\rm B}T) \dots (1)$ 

حيث: σ التوصيلية (Conductivity) σ<sub>o</sub> : ثابت E<sub>a</sub>: طاقة التنشيط

K<sub>B</sub>: ثابت بولتزمان T: درجة الحرارة

توضح الأشكال من (١) الى (٦) ميكانيكية الانتقال الالكتروني وطاقات التشيط CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.2</sub>) و لأغشية CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>) الرقيقة قبل التلدين وبعده عند درجات الحرارة (373K) و (473K) لمدة ساعة.

نلاحظ من خلال هذه الأشكال وجود اليتين للانتقال الألكتروني، الأولى هي عند درجات الحرارة الواطئة والتي عندها تم حساب طاقة التنشيط الأولى ( $E_{\sigma 1}$ ) حيث يكون التوصيل هنا بطريقة القفر أو الانتفاق (Tunneling) بين المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة الممنوعة وأما الية الانتقال الألكتروني الثانية فكانت عند درجات الحرارة العالية نسبيا والتي عندها تم حساب طاقة التنشيط الثانية ( $E_{\sigma 2}$ ) حيث أن التوصيل هنا يكون بطريقة القفز أو التهيج الحراري ( Thermal Excitation)



شكل (۱) العلاقة بين Ln σd.c و 1000/T لغشاء CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>) الرقيق قبل التلدين



شكل (٢) العلاقة بين Ln σd.c و 1000/T لغشاء CuIn (Se<sub>0.8</sub> Te<sub>0.2</sub>) الرقيق قبل التلدين



شكل (3) العلاقة بين Ln σd.c و 1000/T لغشاء CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>) الرقيق بعد التلدين عند درجة حرارة (373K)





شكل (٥) العلاقة بين Ln σd.c و Ln σd.c لغشاء CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>) الرقيق بعد التلدين



شكل (6) العلاقة بين Ln od.c و 1000/T لغشاء CuIn (Se<sub>0.8</sub> Te<sub>0.2</sub>) الرقيق بعد التلدين عند درجة حرارة (473K)

جدول (١) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التتشيط لاغشية CuIn (Se<sub>0.8</sub> Te<sub>0.2</sub>) و CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>)<sub>2</sub>

جدول (٢) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التشيط لاغشية  $CuIn (Se_{0.8} Te_{0.2})_2 \in CuIn (Se_{0.2} Te_{0.8})_2$ بدرجة حرارة (373K)

جدول (3) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التنشيط لاغشية CuIn (Se<sub>0.8</sub> Te<sub>0.2</sub>)2 و CuIn (Se<sub>0.2</sub> Te<sub>0.8</sub>)<sub>2</sub> الرقيقة بعد التلدين بدرجة حرارة (473K)

Concentration	$\sigma_{d.c}$ at 300K	$\sigma_{d.c}$ at 473K	E <sub>al</sub> eV	E <sub>a2</sub> eV
	$(\Omega.cm)^{-1}$	$(\Omega.cm)^{-1}$		
CuIn (Se <sub>0.2</sub> Te <sub>0.8</sub> ) <sub>2</sub>	$1.76 \times 10^{-6}$	2.98×10 <sup>-6</sup>	0.02	0.8
CuIn (Se <sub>0.8</sub> Te <sub>0.2</sub> ) <sub>2</sub>	$1.18 \times 10^{-6}$	1.79×10 <sup>-4</sup>	0.11	0.69

يتضح لنا من الجداول (١، ٢، ٣) نقصان التوصيلية الكهربائية المستمرة لهذه الاغشية مع ازدياد طاقات نتشيط الثانية بزيادة درجة حرارة التلدين وقد يعزى سبب ذلك الى ان عملية التلدين تؤدي الى زيادة انتظام الذرات في التركيب البلوري بشكل او بآخر والذي بدوره قلل من المستويات الموضعية عند حافة الحزم او زيادة فجوة الطاقة فيؤدي الى زيادة الطاقة التي تحتاجها حاملات الشحنة للانتقال الى حزمة التوصيل وبذلك تقل التوصيلية وتزداد طاقات التشيط الثانية لأغشية 2(.80 Se.2 Te.) و التاري التوصيلية وتزداد طاقات التشيط الثانية لأغشية 2(.80 Se.2 Te.) و التاري

ونلاحظ ايضا من خلال الجداول (١، ٢، ٣) بان التوصيلية الكهربائية المستمرة تزداد بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده مما يؤدي الى حاجة حاملات الشحنة الموجودة في حزمة التكافؤ الى طاقة قليلة لعبور فجوة الطاقة ووصولها الى حزمة التوصيل ولهذا فأن قيم طاقات التنشيط الثانية تقل بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده <sup>[2,6,7]</sup>

الاستتتاجات

- $CuIn (Se_{0.2} Te_{0.8})_2$  ازدياد التوصيلية الكهربائية المستمرة لاغشية  $CuIn (Se_{0.2} Te_{0.8})_2$ الرقيقة بزيادة درجة الحرارة وهذه ميزة من مميزات اشباه CuIn (Se\_{0.8} Te\_{0.2})\_2 الموصلات حيث يزداد تركيز حاملات الشحنة بازدياد درجة الحرارة.
- ٢- لوحظ بوضوح وجود اليتين للانتقال الالكتروتي احداهما عند درجات الحرارة الواطئة نسبيا والاخرى عند درجات الحرارة العالية نسبيا للعينات التي لم تلدن وتلك التي تم تلدينها.
- ٣- نقصان التوصيلية الكهربائية المستمرة للاغشية كافة مصاحبا ذلك ازدياد طاقات
  التنشيط الثانية بزيادة درجة حرارة التلدين.
- ٤- از دياد التوصيلية الكهربائية المستمرة للاغشية كافة مصاحبا ذلك نقصان طاقات التنشيط الثانية بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده.

## **References**

 M. Leon "Preparation and some semiconducting properties of CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> thin films grown by triode sputtering" Eighth E. C. photovoltaic solar energy conference. Proceedings of the international conference, helt at Florence, Italy, 9-13 May, Vol. 2, (1988), P. 1077.

- 2. R. Diaz "Preparation and some semiconducting properties of CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> Thin films grown by thermal evaporation" Eighth E.C. photvoltaic solar energy conference. Proceedings of the international conference, helt at Florence, Italy, 9-13 May, Vol.2, (1988), P. 1075.
- F. Rueda "Composition effects in flash evaporated of CuIn (Se<sub>x</sub> Te<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> thin films" J. Vac. Sci. Technol. A 12 (6), Nov./ Dec., (1994), P. 3082.
- 4. R. A. Smith "Semiconductors" 2<sup>nd</sup> edition, (1987).
- 5. R. Fowles "Introduction to Modern Optics" 2<sup>nd</sup> edition, (1975).
- 6. R. J. Eiliott and A. F. Gibson "Introduction to solid state physics and its applications" (1974).
- C. Kittle "Introduction to solid state physics" 5<sup>th</sup> edition, (1976).